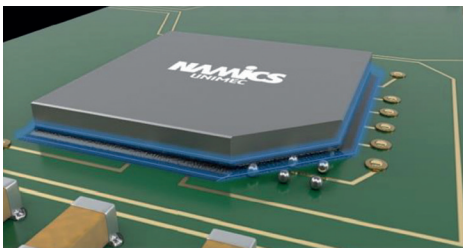


BOARD LEVEL UNDERFILL (SUF)



- Hohes Tg und niedriger CTE bieten höchste Zuverlässigkeit
- Snap Cure in Fast Flow erfüllen die Anforderungen für hohe Produktionsmengen
- Erfüllt die neuesten, strengen Umweltauflagen

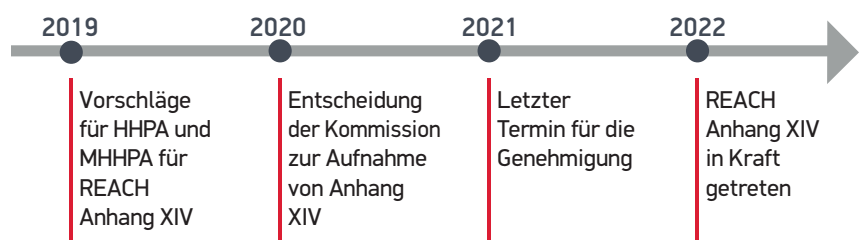
CORNERBOND UND EDGEBOND



- Kontrolle der Fließgeschwindigkeit zur Steuerung des Kapillarflusses unter dem Chip
- Möglichkeit des Jet Dispensing für präzise Dosierkontrolle
- Erfüllt die neuesten strengen Umweltauflagen

NEUE REACH-ANFORDERUNG

- Die ECHA hat 18 neue Chemikalien in die REACH-Verordnung aufgenommen, die aktuelle Materialien betreffen



MATERIALBEDARF FÜR BGA UNDERFILL & CORNERBOND/EDGE BOND

ECHA-konform:

- Erfüllt die Anforderungen der künftigen REACH-Verordnung 2022
- Enthält keine HHPA & MHPA

Hohe Zuverlässigkeit:

- Besteht die Testbedingungen der Richtlinie AECQ 100Grade 1 & 0
- Enthält keine HHPA & MHPA

Ausgezeichnete Verarbeitung:

- Verwendet in kommerziell verfügbarem Equipment
- Snap Cure
- Keine zusätzlichen Schritte oder Equipment erforderlich

UNDERFILL VS. CORNERBOND

| | Underfill | Cornerbond |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Zuverlässigkeit: | | |
| Lotkugelschutz: | +++ | + |
| Fallschutz: | +++ | ++ |
| Temperaturwechsel: | +++ | + |
| Fertigungsdurchsatz: | + | +++ |
| Flussmittel-Kompatibilität: | ++ | +++ |
| Dosiervolumen: | + | +++ |
| Luftabschlusskontrolle: | ++ | +++ |
| Green (Initiative) konform: | +++ | +++ |

MATERIALEMPFEHLUNG

BGA Underfill: XSUF1589-24

- Erfüllt Bedingungsgrad "0" für unübertroffene Zuverlässigkeit und Robustheit aufgrund von hohem Tg und niedrigem CTE
- Optimiertes Harzsystem für schnelle Fließfähigkeit und schnelle Aushärtung
-> Ideal für die Großserienproduktion

BGA Cornerbond: XSUF583-28 & SUF1583-19

- Verbessert die Zuverlässigkeit bei Stößen und Vibrationen
- Hoher Durchsatz und minimaler Materialverbrauch im Vergleich zur Unterfüllung
- Optimierte Fließgeschwindigkeit für minimalen Fluss
- Reworkable Cornerbond verfügbar (SUF1583-19)

Harzsysteme erfüllen die Anforderungen der europäischen Green Initiative

Unser Unternehmen

NAMICS ist ein weltweiter Technologieführer in der Fertigung von elektronischen Baugruppen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und Expertise.

Wir bauen mehr als nur Produkte, wir bauen Beziehungen auf. NAMICS setzt den Goldstandard für Kundenservice. Wir bieten kundenspezifische Produkte und erstklassigen Kundenservice um die passende Lösung für Ihre persönliche Anwendung zu finden.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie NAMICS zu Ihren Zielen beitragen kann.

Kontakt

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
CH-5405 Baden-Dättwil
Telefon: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
office@hilpert.ch
www.hilpert.ch

Mehr Informationen unter:

